日程：7 月 13 日（火）～15 日（木）3 日間

講演：パワー半導体の注目企業 24 社

キヤノン／ハイテック・システムズ ／日本セミラボ／ファーストゲート

タツモ／インターテック販売／ウェールズ政府／SiC アライアンス／大陽日酸

ハーモテック／サムコ／Veeco／列真／CyberOptics／浜松ホトニクス

ノリタケカンパニーリミテド／LPE／ブルカージャパン／上野精機

新光電気工業／住金属工業／TOWA／多加良製作所／上野精機長野（講演順）

特別講演

（1）SiC アライアンス（SiC ロードアップのご紹介）

（2）Power & Compound Fab Report to 2024 のご紹介

費用：聴講無料

オンライン開催（Zoom）で会社や自宅からご参加可能です。

***本セミナーは、講演企業の競合企業の方はご聴講いただけません。**

詳細とお申込みはこちら>> http://semi.jp/power2021

SEMI ジャパン イベント受付　Email: jeventinfo@semi.org

「SEMI パートナーサーチ- For Power & Compound -」の特長

カーボンニュートラル、自動車の電動化で注目されるパワー半導体、5G 時代を支える**化合物半導体**を

テーマに SEMI の会員企業の装置・材料メーカー・団体 23 社が最新技術・製品について詳細に説明します。

	7 月 13 日（火）	7 月 14 日（水）	7 月 15 日（水）
10:00- 10:25	**キヤノン** 「多様な半導体デバイス製造に応えるキヤノン露光装置」	**大陽日酸** 「電子デバイス材料向け MOCVD/HVPE 装置ならびに周辺設備の御紹介」	**ブルカージャパン** 「パワー・化合物半導体向け AFM ナノエレクトロニクス評価技術最前線 ～表面形状からナノスケール電気特性評価まで～」
10:30- 10:55	**ハイテック・システムズ** 「パワーデバイス・MEMS 関連向け海外メーカーの最先端薄膜成膜・エッチング・アニール装置のご紹介」	**ハーモテック** 「特殊ウェーハ搬送メーカによるパワーデバイスウェーハ専用（極薄、TAIKO）ロボットハンド、搬送システムのご案内」	**ブルカージャパン** 「ブルカーが提供する、パワーデバイス・化合物半導体向け自動 X 線検査システム」
11:00- 11:25	**日本セミラボ** 「『ワイドバンドギャップ半導体ウエハーの非接触電気特性マッピング』＆『キャリア分解型ホール効果測定機』」	**サムコ** 「GaN & SiC パワーデバイス向けプラズマエッチングおよび成膜技術」	**上野精機** 「高速搬送、ダメージレス搬送、マイクロクラック外観検査を融合した技術と装置の紹介」
11:30- 11:55	**ファーストゲート** 「SiC ウエハ DRY IN/OUT 全自動枚葉式ポリッシャーと高感度ウエハ表面検査装置のご紹介」	**Veeco** 「5G 以降のソリューション提供（MOCVD, MBE, Wet Cleaning/Etch, IBE, Litho）」	**新光電気工業** 「POL-kW 高出力パワー半導体向けパッケージのご紹介」
13:00- 13:25	**タツモ** 「パワーデバイス製造に対応するウェハー薄化ハンドリングソリューションのご提案」	**列真** 「SIC ウェハー及びエピウェハーの検査装置のご紹介」	**千住金属工業** 「次世代パワーデバイスの課題解決に貢献し得る技術と最新接合材料」
13:30- 13:55	**インターテック販売** 「ウェットプロセスの可能性を広げる液浸技術　～開発から量産まで～」	**CyberOptics** 「ワイヤレス気中パーティクルセンサの紹介」	**TOWA** 「次世代パワー半導体実装におけるモールド封止技術のソリューション」
14:00- 14:25	**ウェールズ政府** 「英国ウェールズと始めるパワー・化合物半導体分野におけるコラボレーション及びビジネスチャンスとは」	**浜松ホトニクス** 「GaN 結晶評価の新手法。全方位フォトルミネッセンス法を用いた内部量子効率測定による結晶欠陥の定量性評価」	**多加良製作所** 「トランスファーモールド成形が切り開く次世代パッケージ」
14:30- 14:55	**SiC アライアンス** 特別講演「ロードマップ紹介」	**ノリタケカンパニーリミテド** 「MOCVD 装置向け洗浄装置、研削・研磨・切断工具用ダイヤモンド工具のご紹介」	**上野精機長野** 「低温～高温での電気特性検査装置／外観検査装置とデータ保存システム」
15:00- 15:25	本講演の終了は、15:30	**LPE** 「Powering the Future - SiC ウエハの圧倒的なパフォーマンスへの道を切り開くエピ成膜先端技術のご紹介」	**SEMI** 「POWER & COMPOUND FAB REPORT TO 2024 のご紹介」

SEMI ジャパン イベント受付　Email: jeventinfo@semi.org